【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第４区分
【発行日】平成25年7月4日(2013.7.4)

【公表番号】特表2011-525442(P2011-525442A)
【公表日】平成23年9月22日(2011.9.22)
【年通号数】公開・登録公報2011-038
【出願番号】特願2011-515735(P2011-515735)
【国際特許分類】
Ｂ３２Ｂ　15/08　(2006.01)
Ｂ３２Ｂ　15/082　(2006.01)
Ｂ０５Ｄ　1/36　(2006.01)
Ｂ０５Ｄ　7/04　(2006.01)
Ｂ６５Ｄ　65/40　(2006.01)
Ｂ６５Ｄ　81/24　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｂ３２Ｂ　15/08　Ｆ
Ｂ３２Ｂ　15/08　１０２Ｚ
Ｂ０５Ｄ　1/36　Ｚ
Ｂ０５Ｄ　7/04
Ｂ６５Ｄ　65/40　Ａ
Ｂ６５Ｄ　81/24　Ｅ

【誤訳訂正書】
【提出日】平成25年5月14日(2013.5.14)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００３６
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００３６】
本発明のもう一つの好適実施形態によれば、前記多層成形可能なフイルムは　含金属層の上に厚さ0.5～250ミクロンのすり減りを防止する層を有している。通常このすり減りを防止する層はシリカ、硫化モリブデン、黒鉛および酸化鉄が含まれる群から選択されるものである。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００６１
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００６１】
本発明のもう一つの好適実施形態によれば、前記多層形成可能なフイルムは　含金属層の上に厚さ0.5～250ミクロンのすり減りを防止する層を有している。一般的にこのすり減りを防止する層はシリカ、硫化モリブデン、黒鉛および酸化鉄が含まれる群から選択されるものである。
【誤訳訂正３】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００８０
【訂正方法】変更
【訂正の内容】

【００８０】
前記工程で作成した二層のフイルムを含金属化装置に移動した。この装置はその場（in situ）プラズマ発生ユニットが付いていて、付着対象の材料（硫化亜鉛）を置くために熱着用ボートが取り付けられていた。このフイルムのプライマーで被覆された面をプラズマで処理して、99.99%純度の硫化亜鉛を熱着した。この熱着された層の厚さは0.025ミクロンであった。含金属化装置内のガンのスピード、高さおよび真空の程度を調整してこの厚さを達成した。
【誤訳訂正４】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
次のものを有する全厚さ1050ミクロン以下の、多層成形可能な包装用フイルム
厚さ10 ～ 500ミクロンの可塑剤を含有しない基板、
上記基板の第一の面にある、厚さ0.1 ～ 1ミクロンのアクリルエステル系コート、
上記コート上に付着されている、既定のパターンがエンボスされた不均一な厚さ0.001～0.3ミクロンの含金属層、および
上記の基板の第二の面に成形された、厚さ50 ～ 1000ミクロンのベース。
【請求項２】
前記成形可能な包装用フイルムが熱成形または冷間成形可能なものであることを特徴とする請求項1に記載の多層成形可能な包装用フイルム。
【請求項３】
前記の基板がポリ塩化ビニル(PVC)、ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)、およびグリコール類と共重合化されたポリエチレンテレフタラート(PETg)、ポリエステル、ポリアミド、ポリスチレンおよびポリスチレンとEVOHの共重合体を含む群から選択された少なくとも一つの高分子樹脂で構成されることを特徴とする請求項１又は２に記載の前記多層成形可能な包装用フイルム。
【請求項４】
前記の基板が1 ppm以下のビニルモノマーを含有し、且つ60 ppm以下の添加物の全体的移行を示すポリ塩化ビニルフイルムで構成されていることを特徴とする請求項３に記載の前記多層成形可能な包装用フイルム。
【請求項５】
前記基板が透明基板、半透明の基板および不透明基板を含む群から選択されることを特徴とする請求項１又は２に記載の多層成形可能な包装用フイルム。
【請求項６】
前記基板は少なくとも一層で構成されていることを特徴とする請求項１～５のいずれか１項に記載の多層成形可能な包装用フイルム。
【請求項７】
基板が着色されていることを特徴とする請求項１～６のいずれか１項に記載の多層成形可能な包装用フイルム。
【請求項８】
前記基板は多層で、少なくともその一層は着色されていることを特徴とする請求項１～７のいずれか１項に記載の多層成形可能な包装用フイルム。
【請求項９】
前記含金属層はアルミ、金、銀、銅および白金からなる群から選択された、99%純度の少なくとも一つの金属から構成されていることを特徴とする請求項１～８のいずれか１項に記載の多層成形可能な包装用フイルム。
【請求項１０】

前記含金属層は酸化亜鉛（ZnO），硫化亜鉛（ZnS），SiO_2 および $SiO_{x-n}N_n$からなる群から選択される99%純度の金属化合物で構成されていることを特徴とする請求項１～８のいずれか１項に記載の多層成形可能な包装用フイルム。

【請求項１１】

前記ベースは透明ベース、半透明のベースおよび不透明ベースからなる群から選択されることを特徴とする請求項１～１０のいずれか１項に記載の多層成形可能な包装用フイルム。

【請求項１２】

前記ベースは少なくとも一層で構成されていることを特徴とする請求項１～１１のいずれか１項に記載の多層成形可能な包装用フイルム。

【請求項１３】

前記のベースがポリ塩化ビニル、ポリプロピレン、ポリエチレン、およびグリコール類と共重合化されたポリエチレンテレフタラート(PETg)、ポリエステル、ポリアミド、ポリスチレンおよびポリスチレンとEVOHの共重合体からなる群から選択された少なくとも一つの高分子樹脂で構成されていることを特徴とする請求項１～１０のいずれか１項に記載の多層成形可能な包装用フイルム。

【請求項１４】

前記基板とベースは一体となって、一層であることを特徴とする請求項１～１３のいずれか１項に記載の多層成形可能な包装用フイルム。

【請求項１５】

前記基板とベースは一体で、多層であることを特徴とする請求項１～１３のいずれか１項に記載の多層成形可能な包装用フイルム。

【請求項１６】

前記ベースは多層のもので、その多層の一層は色素性層になっていることを特徴とする請求項１～１３のいずれか１項に記載の多層成形可能な包装用フイルム。

【請求項１７】

前記フイルムは前記基板とコートの間、コートと含金属層間または含金属層の上に厚さ0.5 ～ 8ミクロンの、着色されたラッカーの少なくとも一層を有してもいいということを特徴とする請求項１～１６のいずれか１項に記載の多層成形可能な包装用フイルム。

【請求項１８】

前記多層成形可能なフイルムは防湿バリア性、酸素バリア性、ガス障壁性又は水蒸気バリア性からなる群から選択される少なくとも一つの性質を有している、厚さ0.5 ～ 250ミクロンの高分子層を有し、該高分子層は、基板内、基板上、コートの下、基板の下、含金属の上又はベース内の少なくとも一つの位置に動作可能に配置されていることを特徴とする請求項１～１６のいずれか１項に記載の多層成形可能な包装用フイルム。

【請求項１９】

前記多層成可能なフイルムは含金属層の上に厚さ0.5 ～ 250ミクロンのすり減りを防止する層を有し、このすり減りを防止する層はシリカ、硫化モリブデン、黒鉛および酸化鉄からなる群から選択されるものであることを特徴とする請求項１～１６のいずれか１項に記載の多層成形可能な包装用フイルム。

【請求項２０】

エンボスパターンは図形パターンおよびテキスト（文字）パターンからなる群から選択され、該図形パターンはダイアモンドパターン、割れたガラスパターン、レインボー（虹）パターン、ドットパターン、正方形パターン、ハニカム（蜂の巣）パターン、フラワー(花柄)パターン、三角パターン、波線パターン、スター・バーストパターン、円形パターン、削痕パターンおよびイメージパターンから選択したものであることを特徴とする請求項１～１９のいずれか１項に記載の多層成形可能な包装用フイルム。

【請求項２１】

次の工程を含む、全厚さ1050ミクロン以下の多層成形可能な包装用フイルムを生産する方法。

ｉ．厚さ10 ～ 1000ミクロンの、可塑剤が含まれていない基板を選択する；
ii. その基板の第一の面に厚さ0.1 ～ 1ミクロンの、アクリルエステル系コートを塗布する；
iii.このコートを不完全に乾燥する；
iv.この不完全に乾燥したコート上に含金属層を付着する；
v.シムを用いてその含金属層をエンボスし、その上にエンボスパターンを作成してその含金属層の厚さを不均一にする；
vi.基板の第2の面に厚さ50 ～ 1000ミクロンのベースを作成する。
【請求項２２】
基板、コート、含金属層の上、基板とベースのあいだ又はベースの下にラッカーを塗布する工程が含まれていることを特徴とする請求項21に記載された多層成形可能な包装用フイルムを生産する方法。
【請求項２３】
溶剤型接着積層法、熱結合、共押し出しまたは乾燥接着法で少なくとも2枚のフイルムを積層（ラミネート）して基板を作成する工程が含まれていることを特徴とする請求項21又は２２に記載された多層成形可能な包装用フイルムを生産する方法。
【請求項２４】
エンボスする工程の前または後で、ベースをラミネートする工程が含まれていることを特徴とする請求項21～２３のいずれか１項に記載された多層成形可能な包装用フイルムを生産する方法。
【請求項２５】
前記シムを90 ～ 150 ^{0}Cで加熱し、
この加熱されたシムを、フイルム上に付着された含金属層に適用して、パターンをエンボス加工により形成し、及び、該エンボス加工されたパターンを上面に有するフイルムを直ちに約20 ^{0}Cまで冷却する、請求項21～２４のいずれか１項に記載された多層成形可能な包装用フイルムを生産する方法。
【請求項２６】
エンボスした含金属層の上にすり減りを防止する層を作成する工程が含まれていることを特徴とする請求項21～２５のいずれか１項に記載された多層成形可能な包装用フイルムを生産する方法。
【請求項２７】
ベースは、2枚の高分子フイルムの間に厚さ20 ～ 150ミクロンのアルミ箔が挟まれた金属・高分子型ラミネートおよびその金属・高分子型ラミネートを基板と結合するために厚さ2 ～ 8ミクロンの接着層で構成されていることを特徴とする請求項１～２０のいずれか１項に記載された多層成形可能な包装用フイルム。
【請求項２８】
前記接着剤層はポリウレタン、アクリル系ポリマー、イソシアン化物またはその混合物からなる群から選択されることを特徴とする請求項27に記載された多層成形可能な包装用フイルム。
【請求項２９】
次の工程を含む、全厚さ1050ミクロン以下の多層成形可能な包装用フイルムを生産する方法；
i.厚さ10 ～ 1000ミクロンの、可塑剤が含まれていない基板を選択する；
ii.その基板の第一の面に厚さ0.1 ～ 1ミクロンの、アクリルエステル系のコートを塗布する；
iii.このコートを不完全に乾燥する；
iv.この不完全に乾燥したコート上に含金属層を付着する；
v.シムを用いてその含金属層をエンボスし、その上にエンボスパターンを作成してその含金属層の厚さを不均一にする；
vi.2枚の高分子フイルムの間にアルミ箔を挟んで、厚さ50 ～ 1000ミクロンのベースを

作成する；
vii.ベース上に厚さ2 ～8ミクロンの接着層を塗布する；
viii.基板にベースを付着する。